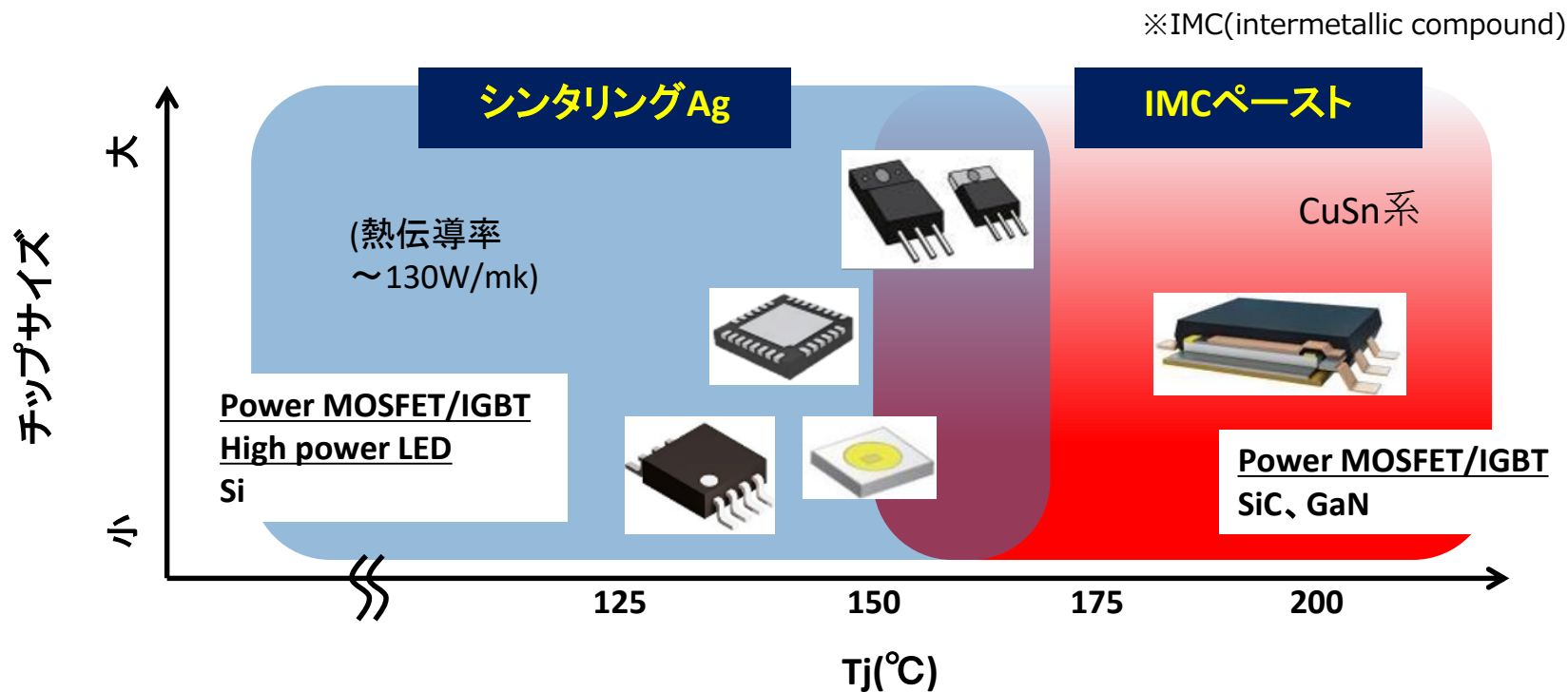


パワーパッケージ用ダイアタッチペースト

■ターゲット



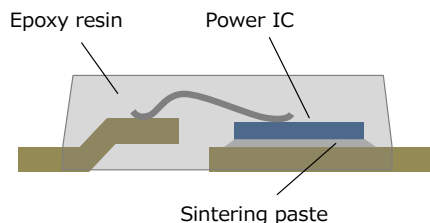
パッケージ : TO-252、パワー-QFN/DFN、SOP等
用途 : 産業機器、車載製品、IPMモジュール等

パワーパッケージ用ダイアタッチペースト

■ TCT結果(シンタリングAgペースト)

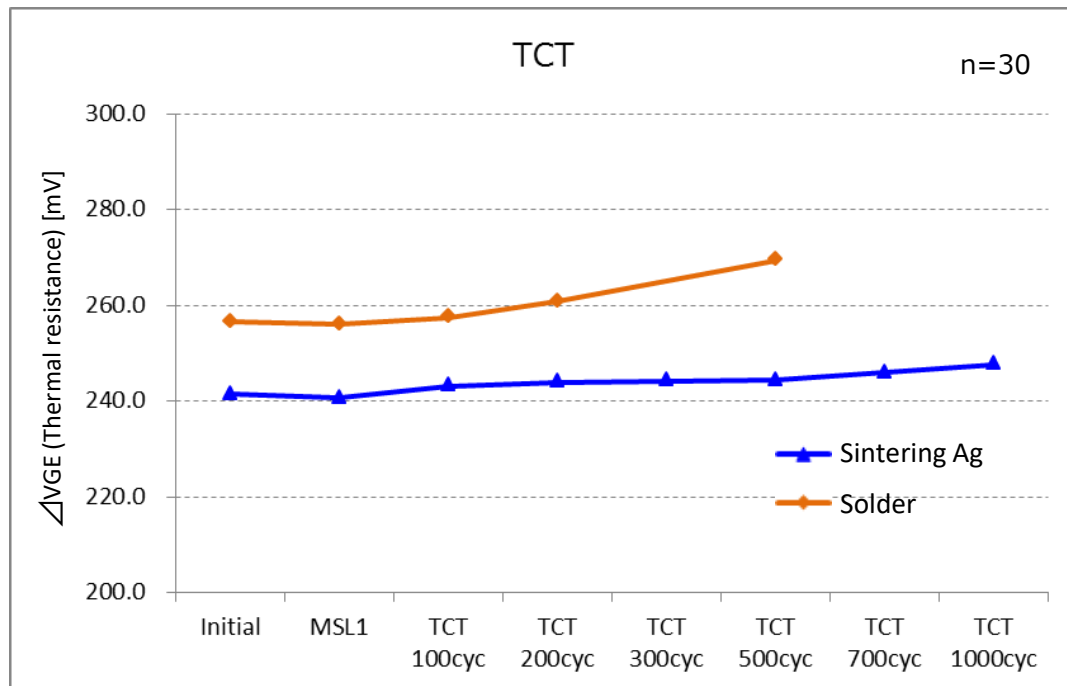
評価内容

- ・形状：TO-252-2
- ・リードフレーム：Cu(0.5mm厚)/PPF
- ・チップ：IGBT (裏面Au)
- ・チップサイズ：3.00×2.50×0.40mmt
- ・TCT条件：-65⇔150°C(15分)



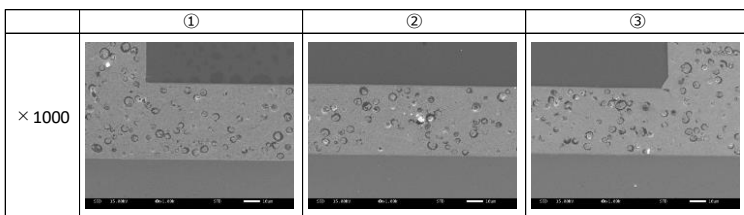
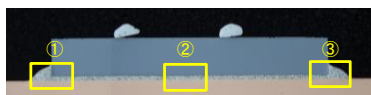
はんだに比べ、シンタリングAgのほうが初期値、変化率共に低く優位性有り

熱抵抗値変化率(AVE)

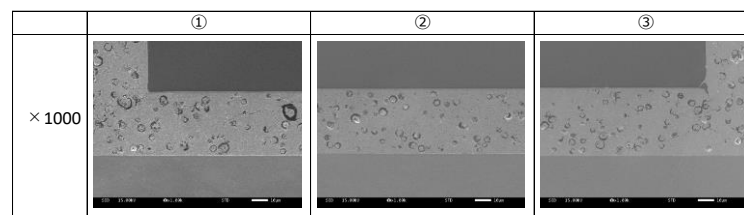
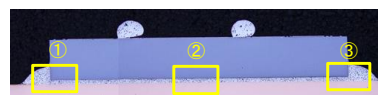


断面観察

イニシャル



TCT 500cyc後



ATTENTION

本資料には機密情報が含まれておりますので、事前にアオイ電子の書面による承諾がない限り、本資料の内容を開示、複製、配布、またはそれに依拠した行為を固く禁じます。

予めご了承くださいませようお願い申し上げます。